

上海硅产业集团股份有限公司

2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	371,603.01	338,761.17	9.69
营业利润	-184,922.73	-116,307.57	不适用
利润总额	-185,183.39	-116,433.85	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-147,575.00	-97,053.71	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-174,252.77	-124,306.16	不适用
基本每股收益（元）	-0.528	-0.353	不适用
加权平均净资产收益率	-11.84	-7.07	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,381,910.06	2,926,984.24	15.54
归属于母公司的所有者权益	1,693,852.83	1,229,926.01	37.72
股本	330,502.34	274,717.72	20.31
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	6.06	4.48	35.27

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况说明

1. 报告期内公司主要经营情况

报告期内，全球半导体市场延续高增长态势，根据 WSTS 及 Techinsights 预测，全球半导体市场规模将达到 7,720 亿美元，与上年同期相比增长 22.5%，AI 应用及数据中心基础设施需求成为核心增长动力，但消费类电子、工业电子等应用仍处于疲软状态，呈现同比微跌趋势。行业复苏的结构性分化，叠加部分领域库存影响，半导体硅片行业的整体市场环境仍具挑战。

根据 SEMI 预测，报告期内，全球半导体硅片出货面积预计同比增长约 5.4%，其中，300mm 半导体硅片受益于先进制程与 AI 芯片需求，出货量持续攀升，产能利用率维持在较高水平；而 200mm 及以下半导体硅片受部分终端市场需求疲软影响，出货面积同比下滑约 3%，产能利用率水平相对较低。同时，报告期内全球半导体硅片（含 SOI 硅片）市场规模预计为 134 亿美元，虽同比微增 2.6%，但 SOI 硅片市场规模仅为 13.2 亿美元，同比下跌 13.6%，部分细分领域仍面临产品价格承压与产能消化压力。

公司的经营表现与整体市场情况一致，其中 300mm 半导体硅片的销量较 2024 年同期增长约为 26%，但由于单价受市场竞争的影响有所下降，导致 300mm 半导体的收入较 2024 年同期涨幅约为 15%；而 200mm 半导体硅片（含 SOI 硅片）的销量较 2024 年同期略增长约 5%，收入也有所增长，其中公司子公司新硅聚合的单晶压电薄膜衬底材料业务增长显著，其收入大幅增长超过 100%；但公司受托加工服务，特别是子公司新傲科技从事的 200mm SOI 硅片的受托加工服务的销量大幅减少，收入减少超过 40%，导致受托加工服务的毛利率转负。

2. 报告期内公司主要财务状况

报告期内公司完成向特定对象发行股份及支付现金购买其持有的公司子公司的股权的交易，共计发行股份 447,405,494 份，增加归属于母公司所有者权益约 46.25 亿元；并完成配套募集资金的发行，收到募集资金净额为 20.78 亿元，

募集资金除用于支付前述股权交易现金对价和发行费用外，将用于补充公司流动资金，有效缓解公司资金压力，为公司进一步拓展业务、研发新产品和新技术提供有效支持。

(二) 主要数据及指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明：

公司报告期内 200mm 半导体硅片业务的销售增长不及预期，特别是 200mm SOI 受托加工业务的销量进一步下滑，经初步商誉减值测试测算，相关资产组需计提的商誉减值损失合计约为 4 亿元。

剔除商誉减值损失的影响后，公司报告期内归属于母公司所有者的亏损增加约 4 亿元，主要是由于随着公司新建 300mm 硅片产能逐步释放，报告期内仅折旧摊销费用同比计提就增加超过 3 亿元，虽然公司报告期内产品整体销量有所增加，但是受公司产品的平均价格下降的影响，公司毛利水平仍承压下降。

同时，作为行业领先的半导体硅片企业，公司始终坚持面向高规格产品、特殊规格产品以及国产化产业链建设等亟需解决的半导体硅片领域的重大战略任务的研发投入，投入规模和占收入比例持续提高。

综合上述影响，公司报告期内的营业利润较上年同期亏损增加约 68,615.16 万元，利润总额较上年同期亏损增加约 68,749.54 万元，归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损增加约 50,521.29 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损增加 49,946.61 万元，基本每股收益较上年同期进一步减少约 0.175 元，加权平均净资产收益率减少 4.77 个百分点。

此外，公司归属于母公司的所有者权益和归属于母公司所有者的每股净资产分别增加 37.72% 和 35.27%，主要是由于公司完成了前述向特定对象发行股份及支付现金购买资产和配套募集资金的交易的影响。

三、风险提示

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，已与会计师事务所进行初步沟通，但未经会计师事务所审计，可能与公司 2025 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2025 年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年2月28日